

全球芯片行业市场竞争与发展趋势预测报告2024-2031年

产品名称	全球芯片行业市场竞争与发展趋势预测报告2024-2031年
公司名称	鸿晟信合（北京）信息技术研究院有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	品牌:鸿晟信合研究院 型号:报告 产地:北京
公司地址	北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0530)（注册地址）
联系电话	010-84825791 15910976912

产品详情

全球芯片行业市场竞争与发展趋势预测报告2024-2031年

【对接人员】：【周文】

【修订日期】：【2024年1月】

【出版单位】：【鸿晟信合研究院】

【报告格式】：【文本+电子版+光盘】

【服务内容】：【提供数据增值+更新服务】

【内容部分有删减·详细可参鸿晟信合研究网出版完整信息！】

【报告价格】：【纸质版6500元 电子版6800元 纸质+电子版7000元(有折扣)】

目录

第1章：芯片行业综述及数据来源说明

1.1 芯片行业界定

1.1.1 芯片的界定

1.1.2 芯片相似概念辨析

1.1.3 《国民经济行业分类与代码》中芯片行业归属

1.2 芯片行业分类

1.2.1 按guojibiaozhun分类

1.2.2 按使用功能分类

1.3 芯片行业监管体系及机构介绍

1.3.1 中国芯片行业主管部门

1.3.2 中国芯片行业自律组织

1.4 芯片产业画像

1.4.1 芯片产业链结构梳理

1.4.2 芯片产业链生态图谱

1.4.3 芯片产业链区域热力图

1.5 芯片专业术语说明

1.6 本报告研究范围界定说明

1.7 本报告数据来源及统计标准说明

1.7.1 本报告quanwei数据来源

1.7.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章：全球芯片行业发展状况分析

2.1 全球芯片行业发展历程

2.2 全球芯片市场发展现状分析

2.2.1 全球芯片市场供给现状

2.2.2 全球芯片市场需求现状

2.2.3 全球芯片市场发展特点

2.3 全球芯片行业市场规模体量

2.3.1 全球半导体行业市场规模

2.3.2 全球芯片行业市场规模

2.4 全球芯片行业市场竞争格局

2.5 全球芯片行业区域发展格局及重点区域市场研究

2.5.1 全球芯片行业区域发展格局

2.5.2 重点区域一：美国芯片行业市场分析

1、美国芯片市场规模

2、美国芯片技术研发进展

2.5.3 重点区域二：韩国芯片行业市场分析

1、韩国芯片市场规模

2、韩国芯片技术研发进展

2.6 全球芯片行业发展趋势预判及市场前景预测

2.6.1 中美贸易战对全球芯片行业发展影响分析

1、中美贸易战对全球芯片行业供应链结构产生的影响

2、中美贸易战对全球芯片价值链重构产生的影响

2.6.2 全球芯片行业发展趋势预判

2.6.3 全球芯片行业市场前景预测

第3章：中国芯片行业发展状况分析

3.1 中国芯片行业发展综述

3.1.1 中国芯片产业发展历程

3.1.2 中国芯片行业发展地位

3.2 中国芯片行业市场主体

3.2.1 芯片市场主体类型

3.2.2 芯片企业进场方式

3.2.3 芯片新注册企业

3.2.4 芯片在业/存续企业

1、芯片行业企业注册资本分布

2、芯片行业注册企业省市分布

3、芯片行业在业/存续企业类型分布

3.3 中国芯片行业经营模式

3.4 中国芯片市场供给情况

3.4.1 中国芯片产能现状

3.4.2 中国芯片产量现状

3.5 中国芯片行业需求情况

3.6 中国芯片产业进出口贸易情况

3.6.1 中国集成电路（芯片）行业进出口贸易概况

3.6.2 中国集成电路（芯片）行业进口贸易状况

1、集成电路（芯片）行业进口贸易规模

2、集成电路（芯片）行业进口价格水平

3、集成电路（芯片）行业进口产品结构

4、集成电路（芯片）行业进口来源地

3.6.3 中国集成电路（芯片）行业出口贸易状况

1、集成电路（芯片）行业出口贸易规模

2、集成电路（芯片）行业出口价格水平

3、集成电路（芯片）行业出口产品结构

4、集成电路（芯片）行业出口目的地

3.6.4 中国集成电路（芯片）行业进出口贸易影响因素及发展趋势

3.7 中国芯片行业市场规模（除港澳台）

3.8 中国芯片产业痛点与应对策略

3.8.1 中国芯片产业痛点分析

3.8.2 中国芯片产业痛点应对策略

第4章：中国芯片行业技术研发及资本动向

4.1 中国芯片行业标准体系建设现状

4.1.1 中国芯片行业标准体系建设

4.1.2 中国芯片行业现行标准分析

- 1、中国芯片行业现行国家标准汇总
- 2、中国芯片行业现行行业标准汇总
- 3、中国芯片行业现行地方标准汇总
- 4、中国芯片行业现行企业标准汇总
- 5、中国芯片行业现行团体标准汇总

4.1.3 中国芯片行业重点标准解读

4.2 中国芯片行业国家投资水平

4.3 中国芯片研发投入&产出

4.3.1 中国芯片研发投入情况

- 1、研发投入力度
- 2、研发投入强度
- 3、研发人员数量

4.3.2 中国芯片科研产出-文献

- 1、文献数量
- 2、文献主题
- 3、发表机构

4.3.3 中国芯片科研产出-专利

- 1、专利数量
 - (1) 专利申请数量
 - (2) 专利公开数量

2、热门技术

3、主要机构

4.3.4 中国芯片技术创新动态

- 1、基于自研架构的国产处理器-龙芯3A6000

2、AI芯片领域-光电子卷积处理器

4.4 中国芯片行业技术工艺及流程

4.5 中国芯片技术路线图/全景图

4.6 中国芯片技术布局动态

4.6.1 技术创新主流模式

4.6.2 关键核心技术

1、EDA软件的开发

2、光刻技术

4.6.3 新兴技术融合发展

4.6.4 技术研发方向/趋势

4.7 中国芯片行业投融资动态及热门赛道

4.7.1 芯片行业融资动态

1、资金来源

2、融资事件

3、融资规模

4、融资轮次

5、热门融资赛道

6、热门融资地区

4.7.2 芯片行业对外投资

4.8 芯片行业兼并重组动态

4.8.1 兼并重组阶段、方式及动因

4.8.2 兼并重组事件

4.8.3 兼并重组案例

4.8.4 兼并重组趋势

4.9 中国芯片企业IPO动态

4.9.1 中国芯片行业IPO企业汇总

4.9.2 中国芯片行业IPO动态追踪

4.9.3 IPO募资规模

4.9.4 IPO板块分布

4.9.5 IPO企业地域分布

4.9.6 行业IPO展望

第5章：中国芯片行业竞争格局及竞争态势

5.1 芯片竞争者入场及布局态势

5.1.1 芯片竞争者入场动因

5.1.2 芯片竞争者入场进程

5.1.3 芯片竞争者集群/梯队

5.2 中国芯片行业企业竞争格局

5.3 中国芯片行业市场竞争程度

5.3.1 芯片行业市场集中度

5.3.2 芯片行业波特五力分析

5.4 芯片海外企业在华市场竞争

5.4.1 海外企业在华市场竞争策略

5.4.2 海外企业在华市场竞争力评价

5.5 中国芯片lingxian企业核心竞争力解构

5.5.1 芯片企业竞争路线/焦点汇总

5.5.2 芯片lingxian企业成功关键因素（KSF）

5.5.3 芯片lingxian企业竞争力雷达图

5.6 中国芯片企业全球化布局及竞争力

5.6.1 中国芯片企业出海/全球化布局

5.6.2 中国芯片企业在全市场竞争力评价

5.6.3 中国芯片企业全球化布局策略

5.7 中国芯片行业国产替代布局状况

5.7.1 中国芯片行业在行业不同环节的国产化替代情况

5.7.2 中国芯片行业在不同细分领域的国产化替代情况

第6章：中国芯片领域细分行业分析

6.1 中国芯片设计行业发展分析

6.1.1 中国芯片设计行业发展历程

6.1.2 中国芯片设计行业市场现状

1、企业数量

2、市场规模

6.1.3 中国芯片设计行业竞争格局

6.2 中国芯片制造行业发展分析

6.2.1 芯片技术现状

6.2.2 中国芯片制造市场现状

1、晶圆代工产能规模

2、市场规模

6.2.3 中国晶圆制造行业竞争格局

6.3 中国芯片封测行业发展分析

6.3.1 芯片封测技术

1、芯片封装技术简介

2、芯片测试技术简介

6.3.2 中国芯片封测行业市场现状

1、主要企业产量

2、市场规模

6.3.3 中国芯片封测行业竞争格局

第7章：中国芯片行业细分产品分析

7.1 芯片行业产品结构概况

7.1.1 芯片产品类型介绍

7.1.2 芯片产品结构分析

7.2 中国模拟芯片市场分析

7.2.1 模拟芯片概况

1、模拟芯片概况

2、模拟芯片分类

7.2.2 模拟芯片市场规模

1、全球模拟芯片市场规模

2、中国模拟芯片市场规模

7.2.3 模拟芯片市场竞争格局

1、全球模拟芯片竞争格局

2、中国模拟芯片竞争格局

7.2.4 模拟芯片的下游应用

7.3 中国微处理器市场分析

7.3.1 微处理器分类

7.3.2 微处理器市场规模

1、全球微处理器市场规模

2、中国微处理器市场规模

7.3.3 微处理器市场竞争格局

1、全球微处理器的竞争格局

2、中国微处理器的竞争格局

7.3.4 微处理器的下游应用

7.4 中国逻辑芯片市场分析

7.4.1 逻辑芯片分类

7.4.2 逻辑芯片市场规模

1、全球逻辑芯片市场规模

2、中国逻辑芯片市场规模

7.4.3 逻辑芯片市场竞争格局

- 1、计算机处理器（CPU）市场竞争格局
- 2、计算机图形处理器（GPU）市场竞争格局

7.4.4 逻辑芯片的下游应用

7.5 中国存储器市场分析

7.5.1 存储器分类

7.5.2 存储器市场规模

- 1、全球存储器市场规模
- 2、中国存储器市场规模

7.5.3 存储器市场竞争格局

- 1、细分产品竞争格局
- 2、企业竞争格局

7.5.4 存储器的下游应用

7.6 中国芯片行业未来细分产品——量子芯片发展进程分析

7.6.1 量子芯片概述

7.6.2 产品发展历程

7.6.3 市场发展形势

7.6.4 产品研发动态

第8章：中国芯片产业价值链及供应链分析

8.1 中国芯片价值链——产业价值属性分析

8.1.1 芯片行业成本投入结构

8.1.2 芯片行业价格传导机制

8.1.3 芯片行业价值链分析图

8.2 中国芯片原材料市场分析

8.2.1 芯片原材料概述

8.2.2 中国半导体材料市场分析

8.2.3 中国硅片市场分析

8.2.4 中国光刻胶市场分析

8.2.5 中国CMP抛光液市场分析

8.2.6 中国芯片原材料发展趋势

8.3 中国芯片关键设备市场分析

8.3.1 芯片关键设备概述

8.3.2 中国半导体设备市场分析

8.3.3 中国光刻机市场分析

8.3.4 中国刻蚀设备市场分析

8.3.5 中国薄膜沉积设备市场分析

8.3.6 中国芯片核心设备发展趋势

8.4 中国芯片其他相关配套产业市场分析

8.4.1 中国芯片算法市场分析

8.4.2 中国芯片IP分析

8.4.3 中国芯片EDA工具分析

8.5 配套产业布局对芯片行业的影响总结

第9章：中国芯片下游应用市场分析

9.1 中国5G芯片发展现状

9.1.1 5G产业发展背景

9.1.2 5G芯片市场发展现状

9.1.3 5G芯片市场竞争格局

9.1.4 5G芯片发展趋势

9.2 中国自动驾驶芯片发展现状

9.2.1 自动驾驶行业发展背景

9.2.2 自动驾驶芯片市场发展现状

9.2.3 自动驾驶芯片市场竞争格局

9.2.4 自动驾驶芯片发展前景

9.3 中国AI芯片发展现状

9.3.1 AI产业发展背景

9.3.2 AI芯片市场发展现状

9.3.3 AI芯片市场竞争格局

9.3.4 AI芯片发展趋势

9.4 中国智能穿戴设备芯片发展现状

9.4.1 智能穿戴设备行业发展背景

9.4.2 智能穿戴设备芯片市场发展现状

9.4.3 智能穿戴设备芯片市场竞争格局

9.4.4 智能穿戴设备芯片发展趋势

9.5 中国智能手机芯片发展现状

9.5.1 智能手机行业发展背景

9.5.2 智能手机芯片市场发展现状

9.5.3 智能手机芯片市场竞争格局

9.5.4 智能手机芯片发展趋势

9.6 中国服务器芯片发展现状

9.6.1 服务器行业发展背景

9.6.2 服务器芯片市场发展现状

9.6.3 服务器芯片市场竞争格局

9.6.4 服务器芯片发展趋势

9.7 中国个人计算机芯片发展现状

9.7.1 个人计算机行业发展背景

9.7.2 个人计算机芯片市场发展现状

1、计算机CPU芯片发展现状

2、计算机GPU芯片发展现状

9.7.3 个人计算机芯片市场竞争格局

1、计算机CPU芯片竞争格局

2、计算机GPU芯片竞争格局

9.7.4 个人计算机芯片发展趋势

第10章：中国芯片产业区域发展格局解读

10.1 中国芯片行业区域发展格局

10.1.1 中国芯片行业企业区域分布

10.1.2 中国芯片行业产量区域分布

10.2 中国芯片产业集群/园区建设现状

10.3 重点区域发展状况：深圳

10.3.1 芯片行业发展环境

10.3.2 芯片行业发展现状

1、芯片行业企业数量

2、芯片行业市场规模

10.3.3 芯片行业细分领域现状

1、IC设计环节

2、IC制造环节

3、IC封测环节

10.3.4 芯片行业发展趋势

10.4 重点区域发展状况：上海

10.4.1 芯片行业发展环境

10.4.2 芯片行业发展现状

1、芯片行业企业数量

2、芯片行业市场规模

10.4.3 芯片行业细分领域现状

1、IC设计环节

2、IC制造环节

3、IC封测环节

10.4.4 芯片行业发展趋势

10.5 重点区域发展状况：台湾

10.5.1 芯片行业发展环境

10.5.2 芯片行业发展现状

1、芯片行业市场规模

10.5.3 芯片行业细分领域现状

1、IC设计环节

2、IC制造环节

3、IC封测环节

10.5.4 芯片技术研发进展

10.5.5 芯片行业发展趋势

第11章：全球及中国芯片企业案例解析

11.1 芯片综合型企业案例分析

11.1.1 英特尔

1、企业基本信息

2、经营效益分析

3、企业产品结构

4、技术工艺开发

5、未来发展战略

11.1.2 三星

1、企业基本信息

2、经营效益分析

3、企业产品结构

4、芯片行业发展

5、技术工艺开发

6、未来发展战略

11.1.3 高通公司

1、企业基本信息

2、经营效益分析

3、企业业务结构

4、技术工艺开发

5、未来发展战略

11.1.4 英伟达

1、企业基本信息

2、经营效益分析

3、企业业务结构

4、技术工艺开发

5、未来发展战略

11.1.5 AMD

1、企业发展概况

2、经营效益分析

3、企业业务结构

4、技术工艺开发

5、未来发展战略

11.1.6 SK海力士

1、企业基本信息

2、经营效益分析

3、企业产品结构

4、芯片行业发展

5、未来发展战略

11.1.7 德州仪器

- 1、企业发展概况
- 2、经营效益分析
- 3、企业产品结构
- 4、企业区域分布
- 5、未来发展战略

11.1.8 联发科技

- 1、企业基本信息
- 2、经营效益分析
- 3、企业产品结构
- 4、企业销售区域分布
- 5、技术工艺开发
- 6、未来发展战略

11.2 芯片设计重点企业案例分析

11.2.1 海思

- 1、企业基本信息
- 2、经营效益分析
- 3、企业产品结构
- 4、技术工艺开发
- 5、最新发展动态

11.2.2 博通有限公司

- 1、企业基本信息
- 2、经营效益分析
- 3、企业产品结构
- 4、收购动态分析

11.2.3 Marvell

- 1、企业发展概况
- 2、经营效益分析
- 3、企业产品结构
- 4、未来发展战略

11.2.4 赛灵思

- 1、企业基本信息
- 2、企业产品结构
- 3、收购动态分析

11.2.5 紫光展锐

- 1、企业基本信息
- 2、经营效益分析
- 3、产品研发进展
- 4、收购动态分析

11.3 晶圆代工重点企业案例分析

11.3.1 台积电

- 1、企业基本信息
- 2、经营效益分析
- 3、公司晶圆代工业务
- 4、产品研发进展
- 5、技术工艺开发
- 6、企业发展战略

11.3.2 格芯

- 1、企业基本信息
- 2、经营效益分析
- 3、晶圆代工业务
- 4、技术工艺开发

5、企业发展战略

11.3.3 联电

1、企业基本信息

2、经营效益分析

3、晶圆代工业务

4、技术工艺开发

5、未来发展战略

11.3.4 力积电

1、企业基本信息

2、经营效益分析

3、晶圆代工业务

4、技术工艺开发

11.3.5 中芯国际

1、企业基本信息

2、企业经营情况分析

3、企业产品结构分析

4、企业晶圆代工业务分析

5、企业技术水平分析

6、企业营销网络分析

7、企业发展战略

11.3.6 华虹

1、企业基本信息

2、企业经营情况分析

3、企业产品结构分析

4、企业营销网络分析

5、企业技术水平分析

11.4 芯片封测重点企业案例分析

11.4.1 Amkor

- 1、企业发展简介
- 2、经营效益分析
- 3、企业销售区域分布
- 4、企业在中国市场投资布局情况

11.4.2 日月光

- 1、企业发展简介
- 2、企业财务情况分析
- 3、企业主营产品及应用领域
- 4、企业产能布局

11.4.3 南茂

- 1、企业发展概况
- 2、经营效益分析
- 3、企业业务结构
- 4、企业营销网络分析

11.4.4 长电科技

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业产品结构分析
- 4、企业营销网络分析
- 5、企业技术水平分析

11.4.5 天水华天

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业产品结构分析

4、企业技术水平分析

5、企业营销网络分析

11.4.6 通富微电

1、企业基本信息

2、企业经营情况分析

3、企业产品结构分析

4、企业产能布局及营销网络分析

第12章：中国芯片行业政策环境洞察&发展潜力

12.1 中国芯片行业政策（Policy）环境分析

12.1.1 国家层面芯片行业政策规划汇总及解读

12.1.2 国家层面重点政策对芯片行业发展的影响分析

1、工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》对芯片行业发展的影响

2、《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》对芯片行业发展的影响

12.1.3 中国芯片行业区域政策热力图

12.1.4 中国芯片产业各省市政策汇总及解读

1、中国芯片产业各省市重点政策汇总

2、中国各省市芯片行业发展目标解读

12.1.5 政策环境对行业发展的影响分析

12.2 中国芯片行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）

12.3 中国芯片行业发展潜力评估

第13章：中国芯片行业市场前景及发展趋势洞悉

13.1 中国芯片行业未来关键增长点

13.1.1 细分产品关键增长点

1、人工智能芯片

2、边缘计算芯片

3、量子计算芯片

4、物联网芯片

5、高性能计算芯片

13.1.2 下游应用关键增长点

1、通信领域

2、工业控制

3、汽车电子

13.1.3 政策规划下的关键增长点

13.2 中国芯片行业发展前景预测

13.2.1 芯片总体前景预测

13.2.2 芯片细分领域前景预测

13.3 中国芯片行业发展趋势洞悉

13.3.1 芯片行业技术发展趋势

13.3.2 行业产品发展趋势预测

13.3.3 行业市场竞争趋势预测

第14章：中国芯片行业投资战略规划策略及建议

14.1 中国芯片行业进入与退出壁垒

14.1.1 进入壁垒

1、技术壁垒

2、人才壁垒

3、资金实力壁垒

4、产业化壁垒

5、客户维护壁垒

14.1.2 退出壁垒

14.2 中国芯片行业投资风险预警

14.2.1 风险预警

1、政策风险

2、宏观经济风险

3、供求风险

4、其他风险

14.2.2 风险应对

14.3 中国芯片行业投资机会分析

14.3.1 芯片产业链薄弱环节投资机会

14.3.2 芯片行业细分领域投资机会

1、自动驾驶

2、卫星通话终端

14.3.3 芯片行业区域市场投资机会

14.3.4 芯片产业空白点投资机会

1、Chiplet技术的发展

2、芯片的存算一体化发展

14.4 中国芯片行业投资价值评估

14.4.1 芯片行业发展空间较大

14.4.2 芯片行业政策扶持利好

14.4.3 芯片下游应用市场增长迅速

14.5 中国芯片行业投资策略建议

14.6 中国芯片行业可持续发展建议

图表目录

图表1：芯片示意图

图表2：半导体、芯片和集成电路概念区分

图表3：《国民经济行业分类（2017版）》中芯片行业所归属类别

图表4：按电路对芯片进行分类

图表5：不同功能的芯片介绍

图表6：中国芯片行业监管体系构成

图表7：中国芯片行业主管部门

图表8：中国芯片行业自律组织

图表9：芯片产业链结构梳理

图表10：芯片产业链生态图谱

图表11：芯片产业链区域热力图

图表12：芯片专业术语说明

图表13：本报告研究范围界定

图表14：本报告quanwei数据资料来源汇总

图表15：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表16：全球芯片行业发展历程

图表17：全球主要半导体厂商芯片产能排名（单位：万片，%）

图表18：2017-2024年全球芯片出货量（单位：亿片，%）

图表19：全球芯片市场特点分析

图表20：2017-2024年全球半导体市场规模及增速（单位：亿美元，%）

图表21：2024年全球半导体细分产品结构（单位：亿美元，%）

图表22：2017-2024年全球集成电路（芯片）市场规模（单位：亿美元，%）

图表23：2024年全球芯片细分产品结构（单位：亿美元，%）

图表24：2024-2024年全球主要半导体厂商业务收入排名（单位：亿美元，%）

图表25：2024年全球区域半导体市场竞争结构（单位：%）

图表26：2024年全球集成电路（芯片）区域市场分布（按企业所在地营收份额）（单位：%）

图表27：2024年全球TOP20半导体厂商分布（不含纯代工厂）（单位：%）

图表28：2017-2024年美国半导体及芯片市场规模（单位：亿美元）

图表29：2017-2024年韩国半导体行业市场规模（单位：亿美元，%）

图表30：全球芯片行业发展趋势预判

图表31：2024-2031年全球芯片行业市场规模预测（单位：亿美元）

图表32：中国芯片行业历程

图表33：2018-2024年中国数字经济规模占GDP比重（单位：%）

图表34：中国芯片行业主体构成

图表35：中国芯片行业主体构成

图表36：中国芯片市场主体数量（单位：家）

图表37：2024年中国芯片企业注册资本分布（单位：家）

图表38：2024年中国芯片企业省市分布（单位：家，%）

图表39：2024年中国芯片市场在业/存续企业类型分布（单位：家，%）

图表40：半导体产业链及业务模式

图表41：垂直分工商业模式

图表42：Foundry（代工厂）模式分析

图表43：IDM（Integrated Device Manufacture）模式分析

图表44：Fabless（无工厂芯片供应商）模式分析

图表45：2024-2024年中国芯片行业代表性厂商产能情况

图表46：2010-2024年中国集成电路（芯片）产量（单位：亿块，%）

图表47：2024年中国芯片行业代表性企业营收与销量情况（单位：亿元，亿片）

图表48：中国集成电路（芯片）行业进出口商品名称及HS编码

图表49：2018-2024年中国集成电路（芯片）行业进出口贸易概况（单位：亿元）

图表50：2018-2024年中国集成电路（芯片）行业进口贸易状况（单位：亿个，亿元）

图表51：2018-2024年中国集成电路（芯片）行业进口价格水平（单位：元/个）

图表52：2024年中国集成电路（芯片）行业进口产品结构（单位：%）

图表53：2024年中国集成电路（芯片）行业进口来源地情况（按金额统计）（单位：%）

图表54：2018-2024年中国集成电路（芯片）行业出口贸易状况（单位：亿个，亿元）

图表55：2018-2024年中国集成电路（芯片）行业出口价格水平（单位：元/个）

图表56：2024年中国集成电路（芯片）行业出口产品结构（单位：%）

图表57：2018-2024年中国集成电路（芯片）行业出口目的地情况（按金额）（单位：%）

图表58：中国集成电路（芯片）行业进出口贸易影响因素及发展趋势分析

图表59：2013-2024年中国集成电路（芯片）市场销售额（单位：亿元，%）

图表60：2015-2024年中国集成电路（芯片）各领域市场结构（单位：%）

图表61：中国芯片产业痛点梳理

图表62：中国芯片产业应对策略

图表63：截至2024年中国芯片行业标准体系建设（单位：项）

图表64：截至2024年中国芯片行业代表性现行国家标准

图表65：截至2024年中国芯片行业的行业标准

图表66：截至2024年中国芯片行业代表性地方标准

图表67：2017-2024年发布的中国芯片行业的企业标准

图表68：截至2024年中国芯片行业的团体标准

图表69：中国芯片行业重点标准解读

图表70：芯片产业基金投资动向统计

图表71：国家芯片产业基金一期部分重点投资企业汇总

图表72：国家芯片产业基金二期部分重点投资企业汇总

图表73：2018-2024年中国芯片行业研发投入力度（规模）（单位：亿元）

图表74：2018-2024年中国芯片行业研发投入强度（占比）（单位：%）

图表75：2018-2024年中国芯片行业研发人员数量及占比（单位：人，%）

图表76：2014-2024年中国芯片行业文献数量（单位：万篇）

图表77：2024年中国芯片行业文献主题及数量汇总（Top10）（单位：篇）

图表78：2024年中国芯片行业发表机构及数量汇总（Top10）（单位：篇）

图表79：2004-2024年中国芯片行业相关专利申请数量变化图（单位：项）

图表80：2004-2024年中国芯片行业相关专利公开数量变化图（单位：项）

图表81：截至2024年中国芯片行业热门技术

图表82：截至2024年中国芯片企业专利排行榜（单位：项）

图表83：芯片制作过程介绍

图表84：中国芯片技术全景图

图表85：中国芯片行业技术创新主流模式

图表86：芯片行业的新兴技术分析

图表87：芯片行业技术研发趋势

图表88：中国芯片行业资金来源

图表89：中国芯片行业重要资金来源解读

图表90：2024年中国芯片行业投融资事件汇总

图表91：2001-2024年中国芯片行业融资规模（单位：起，亿元）

图表92：截至2024年芯片行业融资轮次（单位：起，%）

图表93：截至2024年中国芯片行业热门融资赛道（单位：起，%）

图表94：芯片行业热门融资地区

图表95：2024年中国芯片企业代表性投资事件/项目

图表96：芯片行业兼并重组阶段、方式及动因

图表97：2024-2024年兼并与重组事件汇总（单位：亿元）

图表98：2024-2024年中国芯片行业IPO企业汇总

图表99：2024-2024年中国芯片行业IPO排队情况汇总

图表100：2015-2024年中国芯片行业IPO规模情况（单位：家，亿元）

图表101：2015-2024年中国芯片行业IPO板块分布情况（单位：家，%）

图表102：2015-2024年中国芯片行业IPO企业区域分布情况（单位：家，%）

图表103：中国芯片行业IPO展望

图表104：中国代表性芯片行业竞争者入场进程

图表105：中国芯片行业竞争者集群

图表106：2024年中国芯片行业代表性企业竞争分析（单位：亿元，亿片，%）

图表107：2024年中国芯片行业市场集中度（单位：%）

图表108：芯片行业波特五力模型分析

图表109：海外企业在中国的竞争策略分析

图表110：海外企业在华市场竞争力评价

图表111：芯片企业竞争路线/焦点汇总

图表112：中国芯片xingyelingxian企业成功关键因素分析

图表113：中国芯片xingyelingxian企业竞争力雷达图

图表114：中国芯片企业全球化布局策略

图表115：中国芯片行业在行业不同环节的国产化替代情况

图表116：中国芯片行业在不同细分领域的国产化替代情况

图表117：2014-2024年中国IC设计行业企业数量（单位：家）

图表118：2015-2024年中国芯片设计业销售额（单位：亿元，%）

图表119：2018-2024年国内TOP10芯片设计企业上榜门槛（单位：亿元）

图表120：2024年中国芯片设计公司TOP20（Fabless+IDM）